

SOT-23/TSOT

SOT23提供（小外形晶体管）和 TSOT（薄型小外形晶体管）是基于引线框架的塑封封装，它经过专门设计，适用于需要极小面积的应用。此类符合行业标准的封装采用大批量生产，能够为各种应用提供高成本效率的解决方案。它们拥有 8 个引脚，可以处理之前采用 SOIC 或 TSSOP 封装的小型 IC。

可靠性认证

Amkor 封装合格审定使用三个独立的生产批，每个测试组有至少 77 个器件。所有测试均包括 JSTD-020 湿度预处理。

- ▶ 湿度敏感性特性：JEDEC 级别 3、85°C/85% 相对湿度、168 小时
- ▶ uHAST：130°C/85% 相对湿度、无偏置、96 小时
- ▶ 温度循环：-65°C/+150°C、500 次循环
- ▶ 高温储存：150°C、1000 个小时

服务与支持

Amkor 提供丰富的资源，帮助客户以尽可能低的成本将优质的产品迅速推向市场。

- ▶ 全封装特性
- ▶ 热、机械应力和电性能建模
- ▶ 一站式封装、测试和直接发货
- ▶ 世界级可靠性测试和故障分析

测试服务

- ▶ 程序生成/转换
- ▶ 晶圆探针测试
- ▶ 耐老化性能
- ▶ 可提供 -55°C 至 +165°C 测试
- ▶ 可提供条带测试

发货选项

- ▶ 铝桶
- ▶ 卷带包装
- ▶ 干燥包装
- ▶ 直接代发货



特色

- ▶ 铜线互连，以降低成本
- ▶ 标准 JEDEC 及 EIAJ 封装外形
- ▶ 一站式测试服务、包括条带测试选项
- ▶ 标准绿色材料 – 无铅且符合 RoHS 要求

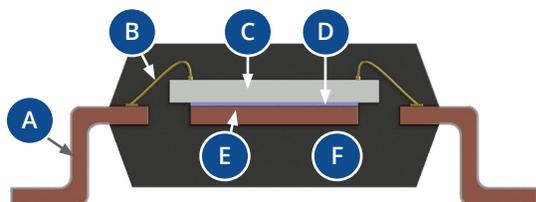
工艺亮点

- ▶ 可提供标准的镀金 PCC 线材、金线和银线
- ▶ 晶圆背面研磨：支持
- ▶ 采用薄膜晶粒贴装材料的可选引脚上芯片封装
- ▶ 标准雾面锡引脚精加工
- ▶ 在封装上使用激光打标

SOT-23/TSOT

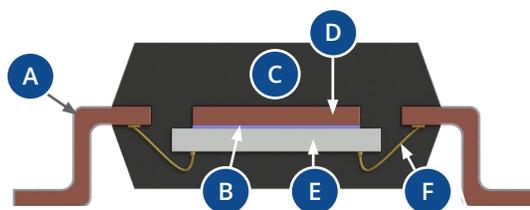
横截面

晶粒朝上



- A** Cu leadframe
- B** Wirebond
- C** Die
- D** Die attach adhesive
- E** Reduced pad
- F** Mold compound

晶粒朝下



- A** Cu leadframe
- B** Die attach adhesive
- C** Mold compound
- D** Reduced pad
- E** Die
- F** Wirebond

配置选项

SOT-23/TSOT 标称封装尺寸 (mm)

封装类型	引脚数量	封装肩宽	封装长度	封装厚度	整体高度	引脚节距	总尺寸	JEDEC/EIAJ
SOT-23	3	1.3	2.9	0.90	0.98	0.95/1.9	2.40	SOT346/ TO-236/SC-59
	4	1.3	2.9	0.90	0.98	1.92	2.40	SOT143/ TO-253
	5	1.6	2.9	1.15	1.23	0.95/1.9	2.80	MO-178
	6	1.6	2.9	1.15	1.23	0.95	2.80	MO-178
	8	1.6	2.9	1.15	1.23	0.65	2.80	MO-178
TSOT*	3	1.6	2.9	0.88	0.96	0.95/1.9	2.75	N/A
	5	1.6	2.9	0.88	0.96	0.95	2.75	MO-193
	6	1.6	2.9	0.88	0.96	0.95	2.75	MO-193
	8	1.6	2.9	0.88	0.96	0.65	2.75	MO-193

*TSOT 也可能被称为 TSOP



访问 amkor.com 或发送电子邮件至 sales@amkor.com 以获得更多信息。

关于本文档中的信息，Amkor 对其准确性或使用此类信息不会侵犯第三方的知识产权不作任何担保或保证。Amkor 对因使用或依赖它而造成的任何性质的损失或损害概不负责，并且不以此方式默示任何专利或其他许可。本文档不以任何方式扩展或修改 Amkor 其任何产品的标准销售条款和条件中规定的保修。Amkor 保留随时对其产品和规格进行更改的权利，恕不另行通知。Amkor 名称和标志是 Amkor Technology, Inc. 的注册商标。所提到的所有其他商标是各自公司的财产。© 2021 Amkor Technology, Incorporated. 保留所有权利。DS5810-CN 修改日期：06/21

